

# SÜSS MicroTec AG

## QUARTALSBERICHT

01. Januar - 31. März 2004



# I KENNZAHLEN Q1/2004

Millionen Euro	Q1/2003	Q1/2004
Auftragseingang netto	25,3	24,4
Auftragsbestand netto	38,5	38,8
Nettoumsatz	17,6	19,2
Eigenkapital	111,8	100,0
Eigenkapitalquote	69%	64,6%
Liquide Mittel (netto)	16,7	22,5
Free Cash Flow	4,6	0,1
Rohertrag	4,7	6,2
Rohertragsmarge	27,0%	32,3%
EBITDA	-7,5	-4,3
EBIT	-9,2	-5,6
EAT (Ergebnis nach Steuern)	-5,8	-5,0
EPS (Ergebnis pro Aktie in Euro)	-0,39	-0,33
Mitarbeiter (Anzahl)	756	720

# INHALT

<b>Editorial</b>	<b>4</b>
<b>Neue Partnerschaften</b>	<b>6</b>
Neue Bonding-Prozesse für Mikrosysteme	6
<b>Neue Produkte</b>	<b>7</b>
Hochwertige Produktionstest in einzigartiger Vielfalt	7
<b>Neue Kunden</b>	<b>9</b>
Sichere Autos mit SÜSS MicroTec-Equipment	9
Wichtige Kunden für „SupraYield“- und „nanoPrep“-Technologie	10
<b>Umsatz und Auftragslage</b>	<b>12</b>
Umsatzentwicklung nach Produktlinien und Regionen	12
Auftragseingang nach Produktlinien und Regionen	13
<b>Finanzbericht</b>	<b>14</b>
Konzerngewinn- und Verlustrechnung	14
Konzernbilanz	16
Konzernkapitalflussrechnung	18
Konzerneigenkapitalentwicklung	20
Rechnungslegungsgrundsätze / Segmentberichterstattung	20
Aktien und Bezugsrechte der Organe	22
Unternehmenskalender 2004	22

### **Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Geschäftspartner der SÜSS MicroTec AG,**

im Geschäftsjahr 2004 ist die Industrie - nach der schon so oft erwähnten historisch schwersten Halbleiterkrise in den letzten zwei Jahren - wieder auf einen Wachstumspfad zurück gekehrt. Typischerweise stellt sich das Wachstum bei uns etwas später ein, wobei wir davon ausgehen, dass sich der Aufschwung im zweiten Quartal in konkreten Auftragseingängen bemerkbar machen wird.

Die Kennzahlen des ersten Quartals waren noch von der schwachen Auftragslage geprägt: Unseren Nettoumsatz verbesserten wir leicht auf 19,2 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 17,6 Millionen Euro); der Auftragseingang blieb mit 24,4 Millionen Euro noch auf dem Niveau der Vorquartale und leicht unter dem Vorjahreswert von 25,3 Millionen Euro. Den Rohertrag steigerten wir um 31 Prozent auf 6,2 Millionen Euro (Vorjahreswert: 4,7 Millionen Euro), die Rohertragsmarge betrug 32,3 Prozent (Vorjahreswert: 27,0 Prozent). Eine klare Verbesserung erzielten wir beim EBITDA: Mit -4,3 Millionen Euro setzte sich das EBIT deutlich positiv vom Vorjahreszeitraum ab (-7,5 Millionen Euro). Grund hierfür waren vor allem weitere Kostensenkungen sowie eine stabilere Währungsentwicklung. Der Free Cash Flow (operativer Cash Flow abzüglich Investitionen) im ersten Quartal war mit 0,1 Millionen Euro leicht positiv, verglichen mit dem Vorjahreswert von 4,6 Millionen Euro jedoch gering. Nichts desto trotz lag diese Entwicklung im Rahmen unserer Erwartungen, der aktuelle Wert ergab sich aus der Vorbereitung auf die bevorstehende Geschäftsbelegung und dem im Zusammenhang damit gestiegenen Lagerbestand.

Auch für das zweite Quartal gehen wir von einem Vorfinanzierungsbedarf für den gestiegenen Auftragseingang aus, denn bereits zu Beginn des laufenden Quartals hat sich die erwartete deutliche Geschäftsbelegung beim Auftragseingang eingestellt. Unter anderem wurde direkt auf



der Messe SEMICON Europa in München ein größerer Auftrag von einem asiatischen Kunden platziert - sehr erfreulich, denn es ist viele Jahre her, dass zum letzten mal direkt auf einer Messe ein Auftrag vergeben wurde. Ein wichtiger Indikator für die Rückkehr zum nachhaltigen Wachstum in 2004 ist die Wiederbelebung der Aufträge für Produktionsequipment, sowohl für den 200mm als auch für den 300mm-Bereich. Auch erwarten wir zusätzliche Umsatzbeiträge von unseren neuen Technologien "SupraYield" und "nanoPREP" sowie von unserem neuen Bond-Cluster. So rechnen wir insgesamt mit einem Auftragseingang über 35 Millionen Euro - womit wir uns deutlich über dem Niveau der letzten zwei Jahre befinden würden. Naturgemäß wird sich diese positive Entwicklung im wesentlichen ab dem dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in einem entsprechenden Umsatzzuwachs und in dessen Folge auch in einem verbesserten Ergebnis niederschlagen.

Auch wenn die herben Verluste der letzten zwei Jahre für das Unternehmen und die Aktionäre eine schwere Bürde waren, ermöglicht uns die über diese Zeit aufrecht erhaltene Struktur das erwartete Wachstum auch bewältigen zu können. Dank der so geschaffenen Überlegenheit, beispielsweise bei Lieferzeiten, konnten wir uns nun bereits mehrfach gegenüber unseren Wettbewerbern durchsetzen. Insofern bestätigen wir an dieser Stelle nochmals unser Ziel für 2004 eines zumindest ausgeglichenen Ergebnisses auf EBIT Niveau, das wir bei einem Umsatz von etwa 115 bis 120 Millionen Euro erreichen werden, und danken für Ihr Vertrauen auf dem Weg dorthin.

Garching, im April 2004

Dr. Franz Richter  
Vorstandsvorsitzender

Stephan Schulak  
Vorstand Finanzen

# I NEUE PARTNERSCHAFTEN

## Neue Bonding-Prozesse für Mikrosysteme

SÜSS MicroTec leitete im ersten Quartal eine neue Stufe der Technologieentwicklung für Device Bonder ein. In enger Zusammenarbeit mit Europas führendem unabhängigem Forschungszentrum für Mikroelektronik und Nanotechnologie, IMEC, erforscht und entwickelt SÜSS MicroTec jetzt erstmals neue Device Bonder-Technologien für die Mikrosystemtechnik.

Das gemeinsame Entwicklungsprogramm zwischen SÜSS MicroTec S.A., Frankreich (eine 100-prozentige SÜSS MicroTec-Tochter und gleichzeitig Hersteller der Device Bonder-Produktlinie) und IMEC (Interuniversity MicroElectronics Center) in Belgien strebt damit zusätzliche Anwendungsbereiche für Device Bonder an.

Bislang kommen Device Bonder („Verbinder“) nach Abschluss der Halbleiterproduktion zum Einsatz. Sie verbinden dort mit höchster Präzision und Justiergenauigkeit die bereits fertig hergestellten und aus dem Waferverbund herausgesägten Bauteile mit dem Endprodukt. In Zukunft sollen Device Bonder bereits auf Wafer-Ebene eingesetzt werden können und dort die Verbindung von Mikrosystem-Bauteilen ermöglichen. Die äußerste Präzision und Positioniergenauigkeit von SÜSS MicroTec-Device Bondern bewirkt dann die exakte Verbindung der kleinsten und hochsensiblen Mikrosysteme selbst bei höheren Produktionsvolumen – ohne die umfassende Leistungsfähigkeit der Mikrosysteme zu beeinflussen.

Dieses gemeinsame Entwicklungsprogramm eröffnet der SÜSS MicroTec Bonder-Produktlinie weitere Einsatzbereiche durch neue technologische Flexibilität – und damit die Erschließung von Zukunftsmärkten.

# NEUE PRODUKTE

## Hochwertige Produktionstests mit einzigartiger Vielfalt

Individuelle analytische Tests von Mikrochips auf Wafer-Ebene sind jetzt während der Produktion noch schneller und effektiver möglich: Im ersten Quartal 2004 führte SÜSS MicroTec sein neu entwickeltes Cluster Probe System (CPS) in den Markt ein – und damit ein Test-Equipment, das eine neue Stufe von Testmöglichkeiten für Chips einleitet.

Das Cluster Probe System lässt sich als so genannte Prober-Station kennzeichnen, die sich für verschiedene Testverfahren beliebig konfigurieren lässt – etwa mit Prober-Zubehör für Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte. Bis zu sechs individuelle Test-Module können an das Cluster „angedockt“ werden und dann gleichzeitig in Aktion treten. Die Analysen selbst werden dann mit der von SÜSS MicroTec gewohnt hohen Präzision und Qualität durchgeführt.

SÜSS MicroTec konzipierte sein neuestes Test-Produkt speziell für Produktionstests von Mikrochips in den Märkten Optoelektronik und Mikrosystemtechnik. Denn gerade hier sind analytische Tests oft sehr zeitintensiv, die Produktionsphasen dadurch aufwendig, lang und entsprechend teuer. Bei der Produktion von Leuchtdioden (LEDs) können sich beispielsweise über 10.000 LEDs auf einem Wafer befinden; eine Lichtspektrumanalyse bei jeder einzelnen LED dauerte pro Wafer bislang rund drei Stunden. Jetzt können in drei Stunden sechs Wafer getestet werden.

Das Cluster Probe System bringt so eine Vielzahl spürbarer Vorteile: Die parallelen Testverfahren erhöhen bei geringerem Platzbedarf die Produktionstestgeschwindigkeit deutlich, steigern damit den Durchsatz und reduzieren gleichzeitig die Handhabungsschritte für den Kunden. Folglich sinken die Produktionskosten spürbar.



Mit dem Cluster-Konzept für Prober knüpft SÜSS MicroTec nicht nur an die erfolgreiche Entwicklung intelligenter Test-Lösungen vom Vorjahr an, sondern überträgt gleichzeitig das nachgefragte Cluster-Konzept anderer Produktlinien (etwa Bonder Cluster) erfolgreich in seinen Bereich Test & Measurement. Erste Kunden haben das Probe Cluster System bereits bestellt.

## Sichere Autos mit SÜSS MicroTec-Equipment

SÜSS MicroTec erhielt im ersten Quartal 2004 einen wichtigen Auftrag aus dem Hauptmarkt Mikrosystemtechnik (MEMS). Die Infineon-Tochter SensoNor, Europas größter Mikrosystem-Hersteller für die weltweite Automobilindustrie mit Sitz in Norwegen, bestellte als Neukunde gleich drei SÜSS MicroTec-Produkte. Die zwei Mask Aligner und der Substrat Bonder werden im Rahmen der Volumenproduktion für Reifendrucksensoren eingesetzt.

Die Automobilindustrie ist der bedeutendste und wachstumsstärkste Bereich im Markt Mikrosystemtechnik. Hier spielen Mikrosysteme etwa im Hinblick auf die Entwicklung von Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle und machen bereits heute rund 20 Prozent vom Preis eines Neuwagens aus. Besonders gefragt und gefordert sind die ausgefeilten Mikrosysteme in der Sensorik für Fahrzeuge. Reifendrucksensoren bilden dabei das größte Wachstumssegment. Rund 250 Millionen sollen bis 2005 jährlich produziert werden – vor drei Jahren lag die Stückzahl noch bei etwa 80 Millionen (NEXUS-Bericht 2004).

Reifendrucksensoren regulieren Druck, Temperatur und Bewegung des Reifen und übernehmen damit eine wichtige Sicherheitsaufgabe. Schon ein minimal verringerter Reifendruck steigert beispielsweise den Spritverbrauch, erschwert das Lenken und verlängert den Bremsweg. Rund 25 Prozent der Unfälle sind nach Aussage des Statistischen Bundesamtes auf falschen Reifendruck zurückzuführen. Umso bedeutender ist es, dass die Herstellung der Sensoren mit höchstem Qualitätsanspruch stattfindet, damit das „Sicherheitssystem“ im Reifen später einwandfrei funktioniert.

SensoNor entschied sich aufgrund der besonderen Präzision, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit („Cost of Ownership“)



des SÜSS MicroTec-Equipments für das Garchinger Unternehmen als neuen Zulieferer. Wichtiger Aspekt für den Kauf der SÜSS MicroTec-Mask Aligner war etwa ihre herausragende Leistung selbst bei der Belichtung dicker Lacke, wie sie in der Produktion von Sensoren verwendet werden. Beim Substrat Bonder überzeugte die hohe Justiergenauigkeit. Denn gerade bei der Verbindung mehrerer Wafer zur Herstellung mikrosystemtechnischer Bauteile ist äußerste Justierpräzision die Voraussetzung für später einwandfrei funktionierende Mikrosysteme.

## **Wichtige Kunden für „SupraYield“- und „nanoPREP“-Technologie**

Die weltweit einzigartigen SÜSS MicroTec-Technologien „SupraYield“ und „nanoPREP“ überzeugten im ersten Quartal 2004 namhafte und strategisch wichtige Kunden.

Mit Unitive (USA) entschied sich einer der weltweit führenden Entwickler und Anbieter von Advanced Packaging-Lösungen für die neue Mask Aligner-Technologie „SupraYield“. Unitive nimmt international eine Vorreiterrolle bei Einführung neuer Technologien ein und hat hier innerhalb der Halbleiterbranche eine Vorbildfunktion. Unitive wählte „SupraYield“ aufgrund der offenkundigen Vorteile der Technologie – und entschied sich gegen das Wettbewerbsprodukt Stepper. Denn „SupraYield“ erweitert den bisherigen Anwendungsbereich der Mask Aligner deutlich und optimiert die Chipproduktion für SÜSS MicroTec-Kunden durch: eine Strukturauflösung bei der Wafer-Vollfeldbelichtung von bis zu 0,5 Mikrometer (statt bisher 5 Mikrometer) bei herausragender Übertragungsqualität; bis zu 60 Prozent geringere Kosten für die Photolithografie im Vergleich zu Steppern sowie eine deutlich höhere Chipausbeute am Ende der Fertigung.



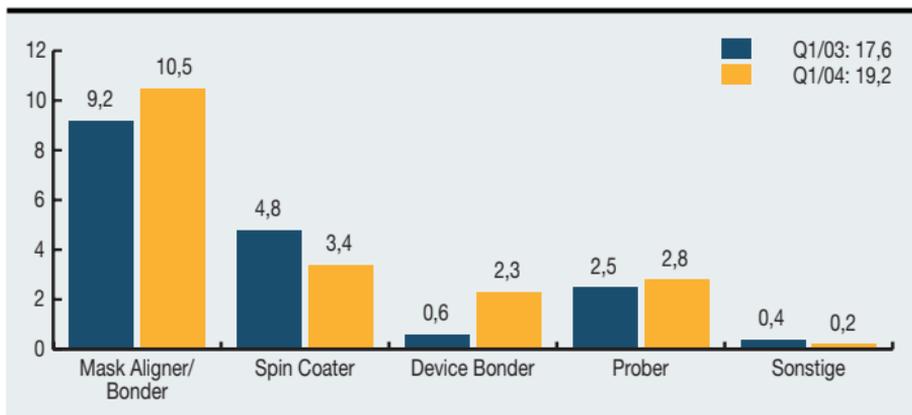
Wichtiger Referenzkunde für „nanoPREP“ wurde im ersten Quartal ITRI, das führende Forschungs- und Entwicklungsinstitut für industrielle Technologie aus Taiwan. ITRI (Industrial Technology Research Institute) gilt als Wegbereiter bei der Einführung neuer Technologien in Taiwans Industrie und arbeitet bei wichtigen strategischen industriellen Projekten eng mit der taiwanesischen Regierung zusammen.

ITRI orderte neben weiterem SÜSS MicroTec-Equipment die „nanoPREP“-Technologie weil sie bei Tests wesentlich bessere Ergebnisse erzielte als Wettbewerbsprodukte. Die „nanoPREP“-Technologie verbessert die Verbindung mikrosystemtechnischer Bauteile durch Einsatz niedriger Temperaturen (maximal 300 Grad Celsius statt wie bisher üblich 1500 Grad Celsius) und bringt Kunden auch im Bonding-Bereich die wesentlichen Vorteile: ein höherer Durchsatz bei Verbindung von MEMS-Bauteilen, äußerst stabile und beständige Wafer-Verbindungen durch einen schonenden Bonding-Prozess sowie deutlich geringere Investitions- und Produktionskosten.

Der Gesamtumsatz von 19,2 Mio. Euro in Q1/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

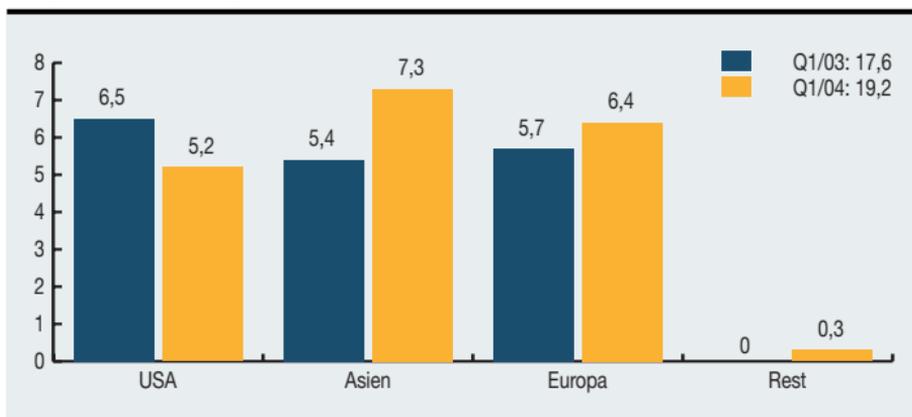
### Umsatzentwicklung nach Produktlinien

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



### Umsatzentwicklung nach Regionen

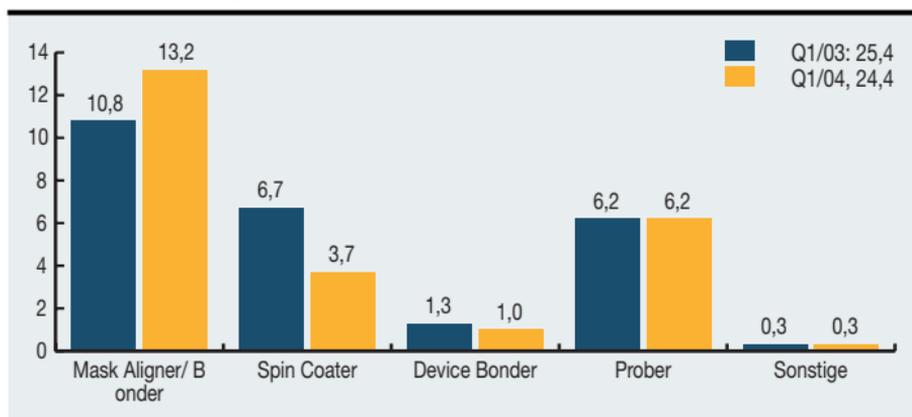
Angaben im Vergleich in Mio. Euro



Der Auftragseingang von 24,4 Mio. Euro in Q1/2004 teilt sich nach Produktlinien und Regionen wie folgt auf:

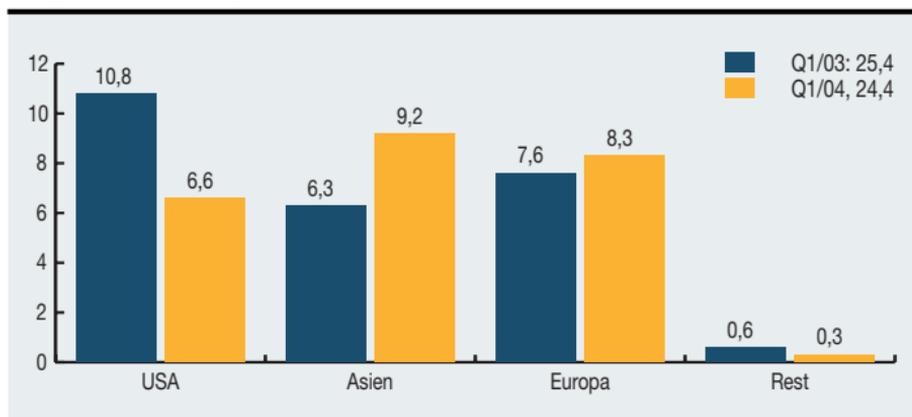
### Auftragseingang nach Produktlinien

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



### Auftragseingang nach Regionen

Angaben im Vergleich in Mio. Euro



# SÜSS MicroTec AG

## KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### TEUR

#### Umsatzerlöse

Frachtkosten und Provisionen

#### Umsatzerlöse netto

Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen

#### Bruttoergebnis vom Umsatz

Allgemeine Verwaltungs- und Vertriebskosten

Forschungs- und Entwicklungskosten

Abschreibung des Firmenwerts

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Erträge / Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung

#### Operatives Ergebnis

Zinsaufwendungen

Zinserträge

Anteil der Minderheitsaktionäre am Ergebnis

#### Ergebnis vor Steuern

Steuern vom Einkommen und Ertrag

#### Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

Earnings before Interest and Taxes (EBIT)\*

Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)\*

Pro Aktie:

Unverwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

Verwässertes Ergebnis pro Aktie in EUR

### Überleitung zum Comprehensive Income

#### Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss

#### Sonstiges Comprehensive Income nach Steuern

Fremdwährungsdifferenzen

Mindestverbindlichkeit für Pensionsrückstellung

Unrealisierte Gewinne aus Wertpapieren

#### Comprehensive Income

\* ungeprüft



01.01.2003- 31.03.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 31.03.2004*
<b>18.281</b>	<b>95.500</b>	<b>20.016</b>
-702	-2.885	-776
<b>17.579</b>	<b>92.615</b>	<b>19.240</b>
-12.832	-56.168	-13.023
<b>4.747</b>	<b>36.447</b>	<b>6.217</b>
-10.514	-40.985	-9.449
-2.436	-10.496	-2.846
0	0	0
-26	859	152
-976	-2.916	269
<b>-9.205</b>	<b>-17.091</b>	<b>-5.657</b>
-213	-1.245	-383
61	358	97
8	24	14
<b>-9.349</b>	<b>-17.954</b>	<b>-5.929</b>
3.540	3.401	975
<b>-5.809</b>	<b>-14.553</b>	<b>-4.954</b>
-9.197	-17.067	-5.643
-7.515	-10.996	-4.302
-0,39	-0,97	-0,33
-0,39	-0,97	-0,33
<b>-5.809</b>	<b>-14.553</b>	<b>-4.954</b>
-1.112	-2.255	447
0	-14	0
0	47	0
<b>-6.921</b>	<b>-16.775</b>	<b>-4.507</b>

# SÜSS MicroTec AG

## KONZERNBILANZ

TEUR	31.03.2003*	31.12.2003	31.03.2004*
<b>AKTIVA</b>			
Flüssige Mittel	18.386	26.785	25.420
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	18.807	23.606	17.207
Sonstige kurzfristige Forderungen	11.228	6.603	6.061
Vorräte, netto	46.913	41.900	45.950
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.311	1.094	1.169
Kurzfristige aktive latente Steuern	5.538	2.091	3.342
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>102.183</b>	<b>102.079</b>	<b>99.149</b>
Sachanlagen	15.264	11.935	11.274
Immaterielle Vermögensgegenstände	9.115	7.305	6.885
Goodwill	28.009	28.009	28.009
Finanzanlagen	148	144	144
Langfristige aktive latente Steuern	4.286	7.480	7.391
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände	2.098	1.901	1.922
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>58.920</b>	<b>56.774</b>	<b>55.625</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>161.103</b>	<b>158.853</b>	<b>154.774</b>

\* ungeprüft



<b>TEUR</b>	<b>31.03.2003*</b>	<b>31.12.2003</b>	<b>31.03.2004*</b>
<b>PASSIVA</b>			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.646	3.154	2.944
Kurzfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	214	158	158
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.302	5.972	5.958
Kurzfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	223	214	212
Kurzfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	3.751	2.991	2.592
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	21.148	16.929	18.786
<b>Summe kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.284</b>	<b>29.418</b>	<b>30.650</b>
Langfristiger Teil der langfristigen Finanzverbindlichkeiten	13.117	22.423	19.580
Langfristiger Teil der Leasingverbindlichkeiten	579	473	438
Langfristiger Teil der Pensionsverbindlichkeiten	3.606	3.581	3.609
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	700	517	514
Minderheitenanteil an Konzerngesellschaften	52	32	21
<b>Summe langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>18.054</b>	<b>27.026</b>	<b>24.162</b>
Gezeichnetes Kapital, genehmigte Anzahl von Aktien zu EUR 1,00 (in tsd.) 22.423 (31.12.2003 und 31.12.2004); davon ausgegeben (in tsd.) 15.157 (31.03.2004) bzw. 14.957 (31.12.2003)	14.957	14.957	15.157
Kapitalrücklage	81.063	81.561	83.421
Gewinnrücklagen	433	433	433
Gewinnvortrag	19.828	11.084	6.130
Kumuliertes Other Comprehensive Income	-4.516	-5.626	-5.179
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>111.765</b>	<b>102.409</b>	<b>99.962</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>161.103</b>	<b>158.853</b>	<b>154.774</b>

\* ungeprüft

# SÜSS MicroTec AG

## KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.2003- 31.03.2003*	01.01.2003- 31.12.2003	01.01.2004- 31.03.2004*
<b>Mittelzufluss aus der laufenden</b>			
<b>Geschäftstätigkeit</b>			
Jahresfehlbetrag	-5.809	-14.553	-4.954
Wechselkursbedingte Veränderung des kurzfristigen Nettovermögens	-701	134	128
<b>Anpassung zur Überleitung des Jahresfehlbetrages zum Mittelzufluss aus der lfd. Geschäftstätigkeit</b>			
Zuführung zur Kapitalrücklage für Bezugsrechte	152	650	100
Steuereffekt auf Kosten der Kapitalerhöhung	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	483	1.965	454
Abschreibung auf den Goodwill	0	0	0
Verminderung Finanzanlagen durch Änderung im Konsolidierungskreis	0	0	0
Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	1.100	3.784	847
Abschreibungen auf Leasinggegenstände	99	322	40
Veränderung der aktiven latenten Steuern	-1.524	-1.271	-1.162
Verlust / Gewinn aus Abgang von Anlagegegenständen	36	551	0
Gewinn aus Beteiligungen	0	4	0
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-153	333	26
Veränderung der Wertberichtigung auf Vorräte	-720	337	-815
<b>Veränderungen von Aktiva und Passiva</b>			
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.451	10.166	6.373
Veränderung der Vorräte	1.869	5.825	-3.235
Veränderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	-353	366	-75
Veränderung der sonstigen Aktiva	-2.137	2.685	521
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	368	2.038	-14
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-3.284	-7.503	1.857
Veränderung der Pensionsverbindlichkeiten	26	-8	26
Veränderung der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten	-35	-238	-14
<b>Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.868</b>	<b>5.587</b>	<b>103</b>

\* ungeprüft



<b>TEUR</b>	<b>01.01.2003- 31.03.2003*</b>	<b>01.01.2003- 31.12.2003</b>	<b>01.01.2004- 31.03.2004*</b>
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>			
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-237	-1.010	-28
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10	0
Auszahlungen für Unternehmenserwerb	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und Finanzanlagen	0	3	0
<b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-237</b>	<b>-1.017</b>	<b>-28</b>
<b>Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus der Begebung einer Wandel- und Optionsanleihe	0	11.642	0
Kosten der Wandel- und Optionsanleihe	0	-502	0
Aufnahme von Bankdarlehen	0	0	0
Tilgung von Bankdarlehen	-1.179	-4.275	-1.348
Änderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-1.885	-377	-302
Tilgungen / Auszahlungen aus dem Finanzierungsleasing	-95	-257	-35
Einzahlungen aus Kapitalerhöhung	0	0	0
Einzahlungen aus Ausübung von Bezugsrechten	0	0	0
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhungen	0	0	0
<b>Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.159</b>	<b>6.231</b>	<b>-1.685</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>			
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.472	10.801	-1.610
Finanzmittelbestand zum Jahresanfang	17.235	16.914	26.785
<b>Finanzmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>18.386</b>	<b>26.785</b>	<b>25.420</b>
<b>Zusätzliche Informationen zur Kapitalflussrechnung</b>			
Zinszahlungen während der Periode	221	773	332
Einkommensteuererstattungen/-zahlungen während der Periode incl. Vorauszahlungen	69	5.273	305
<b>Zusätzliche Darstellung nichtzahlungswirksamer Investitions- und Finanzierungstätigkeiten</b>			
Zugang zum Finanzierungsleasing	33	0	0

\* ungeprüft

# SÜSS MicroTec AG

## KONZERNEIGENKAPITALENTWICKLUNG

TEUR	Anzahl der Aktien in tausend Stück	Gezeichnetes Kapital
<b>Stand 01.01.2003</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
<b>Stand 31.03.2003</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
<b>Stand 01.01.2004</b>	<b>14.957</b>	<b>14.957</b>
Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in Gezeichnetes Kapital	200	200
Zuführung aus der Wandlung von Wandelschuld- verschreibungen		
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		
Jahresfehlbetrag		
Fremdwährungsanpassung		
<b>Stand 31.03.2004</b>	<b>15.157</b>	<b>15.157</b>

### Rechnungslegungsgrundsätze

Die dargestellten Angaben zum Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG entsprechen den Vorschriften der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles („US-GAAP“). Der Zwischenabschluss zum 31. März 2004 wurde unter Beachtung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die auch dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 zugrunde lagen und im Anhang ausführlich erläutert wurden.

### Segmentberichterstattung

Die SÜSS MicroTec AG und ihre Tochterunternehmen sind lediglich in einem Segment tätig. Eine Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Segmente entfällt aus diesem Grund.



Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Gewinnvortrag	Kumuliertes Other Compre- hensive Income	Gesamt
<b>80.911</b>	<b>433</b>	<b>25.637</b>	<b>-3.404</b>	<b>118.534</b>
152				<b>152</b>
		-5.809		<b>-5.809</b>
			-1.112	<b>-1.112</b>
<b>81.063</b>	<b>433</b>	<b>19.828</b>	<b>-4.516</b>	<b>111.765</b>
<b>81.561</b>	<b>433</b>	<b>11.084</b>	<b>-5.626</b>	<b>102.409</b>
				<b>200</b>
1.760				<b>1.760</b>
100				<b>100</b>
		-4.954		<b>-4.954</b>
			447	<b>447</b>
<b>83.421</b>	<b>433</b>	<b>6.130</b>	<b>-5.179</b>	<b>99.962</b>

# SÜSS MicroTec AG

## AKTIEN UND BEZUGSRECHTE DER ORGANE

Aktien und Bezugsrechte der Organe	31.12.2003		31.03.2004	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
<b>Vorstand</b>				
Dr. Richter	400.000	105.000	400.000	105.000
S. Schulak	0	40.286	0	40.286
<b>Aufsichtsrat</b>				
Dr. Süß (Vors.)	1.025.000	0	1.025.000	0
T. Schlytter-Henrichsen (stellv. Vors.)	6.909	0	6.909	0
H. Görtz	3.894	0	3.894	0
Prof. Dr. Heuberger	0	0	0	0
Dr. Schücking	500	0	500	0
Dr. Sesselmann	0	0	0	0

### Unternehmenskalender 2004

- 16.06. Hauptversammlung, München
- 03.08. Halbjahresbericht
- 09.11. Neunmonatsbericht



**| NOTIZEN**

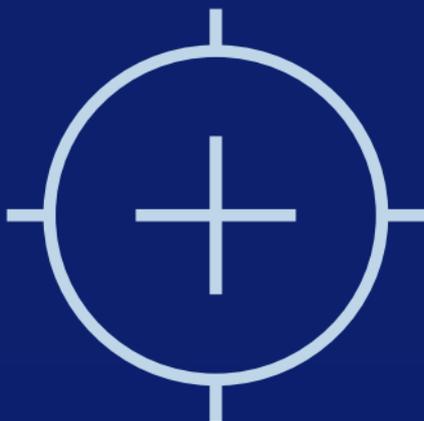
## I **SÜSS MicroTec AG**

Schleissheimer Strasse 90  
D-85748 Garching

Telefon: (+49)-(0) 89/3 20 07-314  
Fax: (+49)-(0) 89/3 20 07-450

E-Mail: [ir@suss.de](mailto:ir@suss.de)

[www.suss.com](http://www.suss.com)



### Gestaltung

strittmatter&jacobs GmbH & Co. KG, Köln

### Druck

Schotte GmbH & Co. KG, Ürdingen

 **SÜSS** MicroTec AG